

参加申込要領

- 参加費(テキスト代含む)

15,000円/1日(消費税込)
- 申込方法

Web siteにて事前申込受付中

http://home.jeita.or.jp/tss/jf2008.html

参加お申し込み後、請求書、受講票を郵送させていただきます。
お申込後に発送させていただく請求書に基づいてお支払いください。
- 申込期限

2008年9月19日(金)

申込み期限内であっても、定員に達した場合は締め切らせて頂きますので、お早めにお申込みください
- 本件担当事務局

105-0005 東京都千代田区西神田3-2-1 千代田ファーストビル南館

社団法人 電子情報技術産業協会 知的基盤部

電話(03)5275-7259 FAX(03)5212-8122

E-mail:jf2008@jeita.or.jp

会場への交通案内



■ アクセス

●JR京葉線:海浜幕張駅 (会場まで徒歩7分)

●JR総武線/京成線:幕張本郷駅(会場までバス15分)

※JR総武線/京成線幕張駅からは交通の便はありませんのでご注意ください。

Jisso フォーラム 2008実行委員会

8月27日現在

委員長	高橋 邦明	エスベック株式会社	技術開発本部 ソリューションセンター 開発部長
副委員長	春日 尋 夫	NECエレクトロニクス株式会社	経営企画部 渉外マネージャ
副委員長	春 田 亮	株式会社ルネサステクノロジ	実装・テスト技術統括部 汎用パッケージ設計部 部長
委員	植垣 祥司	ASEマーケティングアンドサービスジャパン株式会社	ビジネスディベロプメント部 シニアマネージャ
委員	間仁田 祥	カシオ計算機株式会社	研究開発センター第一開発部第11開発室リーダー
委員	荒金 秀幸	ソニー株式会社	モノ造り技術センター 技術標準室 先端実装技術マネージャ
委員	松 井 淳	TDK株式会社	TDKテクノ
委員	山本 克己	テクノオフィス ヤマモト	代表
委員	梅垣 淳一	日本電気株式会社	システム実装研究所業務マネージャ
委員	村上 秀策	パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社	電子部品実装ソリューションビジネスユニット 企画グループ
委員	西 邦 彦	株式会社日立製作所	ものづくり技術事業部 ものづくり技術サポータ 主管技師
委員	服部 友彦	富士機械製造株式会社	ハイテック事業本部 マーケティング室 室長代理
委員	角井 和久	富士通アドバンステクノロジー株式会社	実装技術開発センター プロジェクト部長
委員	反田 哲史	三菱電機株式会社	先端技術総合研究所 マテリアル技術部 部長
委員	梶 田 栄	株式会社村田製作所	市場渉外部 専任部長
オブザーバー	三 沢 義 彦	松下電器産業株式会社	生産革新本部 実装技術研究所 技術顧問
オブザーバー	島田 克己	JISSO株式会社	専務取締役
主催事務局	宮川幸次郎	社団法人 電子情報技術産業協会	知的基盤部 標準・安全グループ部長代理
	細川 照彦	社団法人 電子情報技術産業協会	知的基盤部 標準・安全グループG副長

デジタルコンバージェンスを支えるJissoの今日・明日

Jisso フォーラム 2008

期 日

2008年
10月1日(水)~3日(金)

会 場

アパホテル&リゾート
東京ベイ幕張ホール

主 催

社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)
Jisso戦略専門委員会
実装技術標準化専門委員会

企 画

Jisso フォーラム 2008 実行委員会

Jisso フォーラム 2008

開催に際して

今回CEATEC JAPANと同時開催される Jisso フォーラム 2008では、Jisso関係の“ものづくり”技術者にとって関心が高い先端技術に関する最新の話題提供を取り上げております。具体的にはカーエレクトロニクス関係・半導体パッケージ関係・実装材料関係に焦点を絞り、そこに使われるJisso技術を解き明かそうとしています。

今後の伸張が期待されている先端商品を安心して確実にマーケットへ投入するためにはどのような実装事例や実装技術があるのか？ あるいは今後の新しい商品を創り出していくための最先端技術動向はどうなっているのか？ 新機能の追加や機能向上と同時に価格低下に対応するためのコストダウン技術はどのように実施されているのか？ また最近増加傾向である商品のリコール・品質信頼性に関する不具合を出さないために高性能と高品質・高信頼性をどのように両立しているのか？など、これらの疑問に対する解決の糸口あるいはヒントを見出せるようなフォーラムを企画いたしました。

日本には優れた 実装用の材料、小型薄型化、省資源化、省エネ化、高性能設備とプロセス技術、高耐久性、高信頼性、高品質化技術等を持っており、それらを有機的に結合させて商品開発から“ものづくり”までを構築できる“ものづくり力”を持っているはずです。このように優れた “Jissoものづくり力”を結集して擦り合わせ型商品を創っていくことがますます求められているのではないのでしょうか。

初日の話題提供として“カーエレクトロニクス実装に求められる技術を解き明かす”というテーマでカーエレクトロニクス関係の実装技術に関してECUやカーナビ・パワー半導体・高信頼の電子部品など具体的な事例を多数紹介します。

2日目は“半導体パッケージ技術の最新状況”というテーマで半導体回路の動向や最新の半導体パッケージ技術（SiP、TSV、3D）を紹介いたします。

3日目は、“環境や資源問題と実装材料－現状の課題と今後”というテーマでリサイクル技術やレアメタルの供給動向、環境対応用実装材料の管理方法や実装材料のコスト低減など新たな定義と実施例など、実装材料技術を紹介します。これら3日間の話題提供は各技術分野のトップレベルの方々にご紹介いただくことにしております。

“ものづくり”技術を支えておられるJisso業界の方々へ是非このフォーラムへの積極的なご参加をよろしくお願い申し上げます。

社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）
Jissoフォーラム 2008実行委員会
委員長 **高橋 邦明**

10月1日 **水**

カーエレクトロニクス実装に 求められる技術を解き明かす

12:55

▼
13:00

Jissoフォーラム2008 開会あいさつ

エスベック株式会社
技術開発本部 ソリューションセンター 部長
高橋 邦明 氏

13:00

▼
13:50

ECUを中心としたカーエレクトロニクス に求められている実装技術課題

株式会社デンソー
電子機器事業グループ 実装企画室 室長
神谷 有弘 氏

13:50

▼
14:40

日本と世界のECU・カーナビ・ PNDの実装技術を紹介する

セミコンサルト
代表
上田 弘孝 氏

15:00

▼
15:40

パワー半導体デバイスの パッケージ・実装技術と課題

富士電機デバイステクノロジー株式会社
電子デバイス研究所 所長
高橋 良和 氏

15:40

▼
16:20

車載電子部品の 信頼性評価技術の実際

株式会社村田製作所
品質管理部自動車信頼性技術課 課長
岡田 誠一 氏

16:20

▼
17:00

高放熱基板材料技術と課題

日立化成工業株式会社
先端材料開発研究所 主管研究員
竹澤 由高 氏

10月2日 **木**

高密度実装を牽引する 先端半導体パッケージ技術

11:00

▼
11:40

集積回路の将来と課題

東京大学
生産技術研究所 教授
桜井 貴康 氏

11:40

▼
12:20

More Mooreと More than Moore

NECエレクトロニクス株式会社
実装技術部 シニアエキスパート
中島 宏文 氏

13:20

▼
14:00

最新SiP技術

株式会社ルネサステクノロジ 技術開発統括部
システムパッケージ設計部 主任技師
菊池 卓 氏

14:00

▼
14:40

最新TSV技術と応用展開

株式会社ザイキューブ
取締役 技術部長
中村 博文 氏

15:00

▼
15:40

次世代3D実装デバイス ”MIPTEC”

松下電工株式会社
コネクタ事業部 MIPTEC商品部
牧永 仁 氏

15:40

▼
16:20

Embedded LSI Package Technology

日本シイエムケイ株式会社
電子デバイス事業部
山田 学 氏

※講演内容は変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
変更内容は随時ホームページでご案内いたします。

10月3日 **金**

環境・資源問題と実装材料 －現状の課題と今後－

11:00

▼
11:40

先端産業に不可欠な レアメタルの供給動向

独立行政法人 石油・天然ガス金属鉱物資源機構
希少資源備蓄部 企画課 課長
北 良行 氏

11:40

▼
12:20

実装材料のリサイクル技術 （プリント配線板を中心に）

日立化成工業株式会社 新材料応用開発研究所
リサイクル技術グループ 主管研究員
柴田 勝司 氏

13:20

▼
14:00

REACHの時代： 適正な製品化学物質管理とは？

社団法人産業環境管理協会
アーティクルマネジメント推進室 室長
片岡 功 氏

14:00

▼
14:20

第2世代フロー用 鉛フリーはんだの特徴

千住金属工業株式会社
開発技術部 テクニカルセンター
大西 司 氏

14:20

▼
14:50

松下電器産業における第2世代 フロー用鉛フリーはんだ採用事例

松下電器産業株式会社
パナソニックAVネットワークス社鉛フリーPT リーダー
川島 泰司 氏

15:10

▼
15:50

高温鉛フリーはんだ開発状況

株式会社日立製作所
生産技術研究所 主管研究員
芹沢 弘二 氏

15:50

▼
16:10

JEITAにおける 「はんだ材料のハロゲンフリー定義」活動

ソニー株式会社
モノ造り技術センター技術標準室 先端実装技術マネジャー
荒金 秀幸 氏

16:10

▼
16:40

富士通における機器の ハロゲンフリー化実施例

富士通株式会社
テクノロジセンター プロセス技術開発センター
山本 敬一 氏

（9月5日現在）

聴講のお申し込みは

<http://home.jeita.or.jp/tss/jf2008.html>

Jisso FORUM 2008